Korean Industrial Property Office

PUBLICATION (Extracted translation)

Registration No.:

U1985-0002080

Date of Registration: 21 September 1985

Publication No.:

U1985-0004585

Publication Date:

22 July 1985

Application No.:

Utility Model No. 1983-0008495

Application Date:

30 September 1983

Owner:

Joo-il Kim

82-11 Mooak tenement house, Chongro-ku, Seoul, Republic of Korea

Title of the Invention:

Combination of Aluminum Heat-dissipating Plates for Amplifier

Claim 1:

A combination of aluminum heat-dissipating plates for an amplifier, comprising heat-dissipating plates (2,2') combined with a predetermined separation gap (1,1')therebetween, each of the heat-dissipating plates having a rectangular uneven (5,5') or planer lower portion (4,4') having assembly holes (6,6') through which volts (7,7') are inserted and coupled with nuts (8,8').

(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 실용신안공보(Y1)

(51) o Int. Cl. 6

(11) 등록번호 (24) 등록일자

실 1985-0002080

H05K 7 /20 (21) 출원번호

실 1983-0008495

(65) 공개번호

1985년09월21일 실 1985-0004585

(22) 출원일자

1983년09월30일

(43) 공개일자

1985년07월22일

(73) 실용신안권자

김주일

서울특별시 종로구 무악동 무악연립 82동 11호

(72) 고안자

김주일

서울특별시 종로구 무악동 무악연립 82동 11호

(74) 대리인

MANEET TESTS (SEATER THATE)

(54) 앰프용 결합식 알미늄 방열판

22

내용 없음.

/######

£1.7

 $\mathcal{GMM}_{\mathcal{M}}$

[고안의 명칭]

앰프용 결합식 알미늄 방열판

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 고안의 결합상태의 사시도.

제2도는 본 고안 제1도의 A-A선 단면도.

제3도는 본 고안의 다른 실시예도.

제4도는 본 고안제3도의 B-B선 단면도.

[실용신안의 상세한 설명]

본 고안은 본원 출원인이 선 등록한 실용신안등록 제23630호(공고번호 82-2681호)를 이용하고 보완하여 보다 조립 작업이

용이하고 방열판의 결속을 견고하게한 앰프용 결합식 알미늄 방열판에 관한 것이다.

선등록 고안은 방열용량에 따라 대류 촉진을 원활하게 하고 열의 방출을 빠르게하며, 자체의 중량을 경량화 시킬 수 있는 등의 여러 장점이 있으나, 방열판과 기판을 따로이 제작하여야 되는 불편과 기판에 대한 방열판의 결속력이 약한 결점이 있었다.

본 고안은 전기한 바와같은 선등록 고안의 결점을 제거키 위하여 고안한 것으로서,

첨부된 도면에 의하여 그 구조 및 작용효과를 상세히 설명하면 다음과 같다.

일정간격(1)(1')으로 격리 조립되게한 얇은 단위방열판(2)(2')에 수 개의 원형 또는 정방형의 대류촉진공(3)(3')을 천공한 방열판에 있어서, 그 하단부(4)(4')를 요철부(5)(5') 또는 사각형으로 형성하여 이에 공통된 조립공(6)(6')을 천공하여 세장한 볼트(7)(7') 및 넛트(8)(8')로 조립 교정 되게한 구조로서 본 고안의 작용효과를 상세히 설명하면, 본 고안은 기판이 차지하는 면적을 없애므로써, 방열판(2)(2')의 간격(1)(1')을 최소한으로 작게 할 수 있고, 방열판(2)(2')에는 공지의 대류촉진공(3)(3')을 형성한 것이어서, 앰프내에 발생되는 열을 효과적으로 방열되게함은 물론, 방열판(2)(2') 하단부(4)(4')의 요철부(5)(5')에 의하여 조립이 용이함과 동시에 조립공(6)(6')에 세장한 볼트7)(7')를 삽입하여 넛트로 용이하게 조립되는 것이어서, 방열판(2)(2')간의 결속이 견고하며, 재료의 절감으로 원가를 절감할 수 있는 것이며, 또한 중량을 경감시켜 앰프 및 컴퓨터에 사용을 용이하게 할 수 있고, 조립식이므로 규격의 다양화와 운반 및 사용을 용이하게 구성한 것이다.

또한 제3도 및 제4도의 다른 실시예와 같이 방열판(2)(2')의 하단부(4)(4')를 사각형으로 하여 수 개의 방열판(2)(2')의 결합을 보다 빠르고 손쉽게 결합할 수 있는 특징이 있고, 특히 제작 성형을 용이하게 할 수 있는 것이 특징이다.

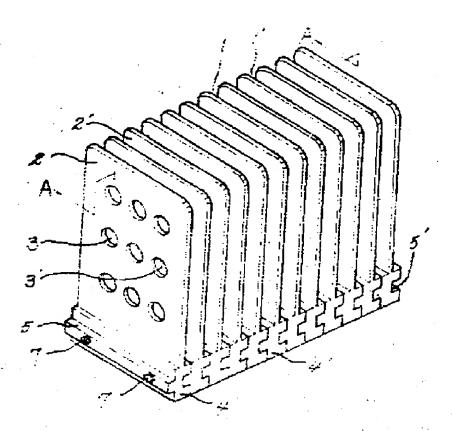
15万 参平部 多种

청구항 1. 일정간격(1)(1')으로 조립된 방열판(2)(2')에 매류촉진공(3)(3')을 형성한 방열판에 있어서, 그 하단부 (4)(4')에 요절부(5)(5') 또는 사각형을 형성하고, 이에 조립공(6)(6')을 천공하여 볼트(7)(7') 및 넛트(8)(8')로 조립되게 함을 특징으로 하는 앰프용 결합식 알미늄 방열판.

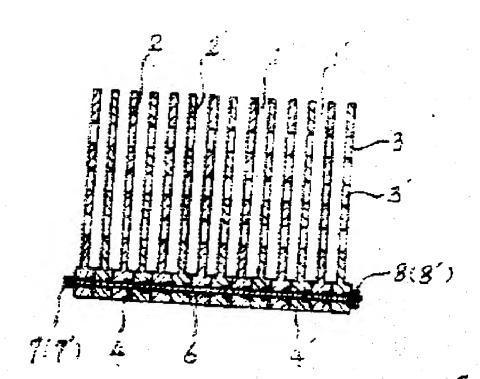
THE PERSON NAMED OF THE PARTY O

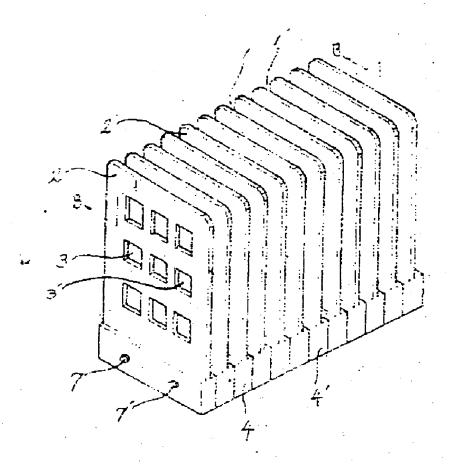
9.25

111.12.7



9.1 *(18*15)





 $\mathcal{L} \in \mathcal{F}$

